

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

## 深圳市昌红科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号: 2026-004

|               |   |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他   |
| 参与单位名称及人员姓名   | 天风证券、老鹰投资、弘洛基金、恒邦兆丰等 16 名投资者  |
| 时间            | 2026 年 7 月 6 日 15:00-16:00  |
| 地点            | 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科技研发楼 3 楼会议室  |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事会秘书: 刘力先生<br>证券事务代表: 陈晓芬女士、程筱玥女士  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>一、介绍公司情况</b></p> <p>公司致力于为客户提供从产品设计、精密模具智能化制造、自动化集成、多样化注塑成型的一站式整体解决方案, 将公司的一个底层技术应用于三大领域, 即医疗器械及高分子塑料耗材、智能制造产品以及半导体耗材。公司业务主要为医疗器械及高分子塑料领域、智能制造领域及半导体耗材领域提供精密模具和自动化生产集成的整体解决方案。</p> <p><b>二、问题与交流</b></p> <p><b>1、公司半导体板块产品市场空间及进展如何?</b></p> <p><b>回复:</b> 公司控股子公司鼎龙蔚柏重点布局 FOUP、FOSB、HWS、光罩载具、超洁净桶等半导体晶圆载具及洁净耗材产品, 目前多个产品已进入国内多家主流晶圆厂、硅片厂、封测厂、掩膜版厂及湿电子化学品厂的小批量试用及验证阶段。根据行业测算, 国内相关产品市场规模合计约 30 亿元。公司将积极推进 FOUP、FOSB、光罩载具等产品的客户验证及市场拓展。</p> <p><b>2、请问公司的晶圆载具等半导体耗材产品已经给长江存储/合肥长鑫/华虹半导体等公司供货吗? 请问主要提供哪些产品?</b></p> <p><b>回复:</b> 受商业保密协议约束, 公司不便披露具体客户名称。公司半导体相关产品已于 2025 年导入国内某头部存储芯片厂商供应链, 并取得相关订单, 订单份额较前期有所提升; 另一家头部存储芯片厂商及逻辑芯片厂商的产品验证工作正在推进</p> |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>中。鼎龙蔚柏专注于半导体高端晶圆载具及洁净耗材的研发、生产与销售，核心产品包括 12 寸 FOUNDRY、FOSB、HWS、光罩载具及各类超洁净包装耗材。</p> <p><b>3、韩国一诺仪器考察了昌红科技，后续在 MPO 连接器有哪些深度合作？有无可能进入 MT 插芯业务？</b></p> <p><b>回复：</b>一诺仪器主营产品包括光纤熔接机等光通信设备，对 MPO 连接器产业较为熟悉，双方围绕 MPO 连接器产业发展趋势、市场需求及产业链协同等方面进行了交流。MT 插芯为 MPO 连接器核心关键零部件，产品生产对模具精密度要求较高，在微孔型腔精度、热膨胀匹配、内应力控制及翘曲度管控等注塑工艺环节具有较高技术壁垒。公司目前正结合自身精密模具及注塑制造优势，对相关产品开展技术可行性论证，相关业务尚处于前期论证阶段，后续研发及产业化进展存在一定不确定性。</p> |
| 附件清单(如有) | 无  |
| 日期       | 2026 年 7 月 6 日   |